

2026年 法人說明會

財務長 邱智芳 2026.9.17

股票代號：3444

發言人：盧修滿處長 / claire@niching.com.tw
代理發言人：邱智芳處長 / chris@niching.com.tw
股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw





投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外在風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。

AGENDA

- 01 2026 策略轉型
- 02 2026 Q2 營運成果
- 03 產品布局與發展
- 04 營運展望



01

2026策略轉型

透過併購驅動營收成長、營運模式與公司價值定位提升



1 M & A 啟動跳躍式成長

2026/7/1 併購明鈞源

2026年上半年 (未含明鈞源)

5.08億

投資金額

6% → 82%

持股比率

2026年下半年 (明鈞源併入報表)

約100人

明鈞源員工

桃園 + 惠州

營運據點

明鈞源核心能力: Heat Spreader、SSD 外殼產品 | 精密沖壓 | 模具設計 Know-how

併購綜效 × 成長動能



今年營收成長

+20% ~ +30%

受惠明鈞源併表與既有業務成長



三年營收目標

挑戰倍增

散熱與 SSD 新動能推升規模



EPS 成長動能

2027 年起大幅成長

高毛利產品放量帶動獲利提升



毛利率目標

2027 年達 30%

產品組合優化與併購綜效顯現

2 公司定位升級

2026不是單純的營收成長，也是「營運模式」與「公司價值定位」的轉折年

代理商



具備 銷售/技術/研發/製造的
完整價值鏈

M&A
策略轉型



3 公司簡介

創 立：1993年

資本額：4.5億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司



高雄分公司



蘇州子公司

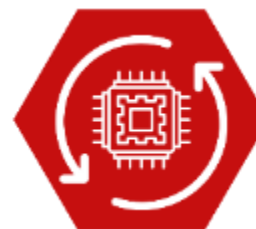


明鈞源
桃園總公司



明鈞源
廣東子公司

營業項目：



通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、
零件與設備



自有研發與製造

1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿
5. TIM材



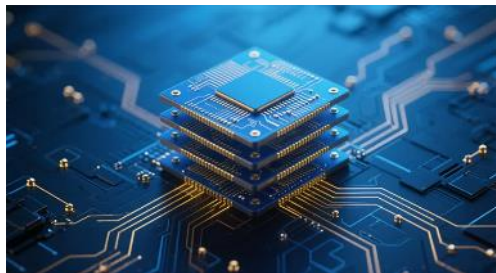
M&A

1. 均熱片 (Heat Spreader)
2. SSD外殼
3. 生醫材料

4

產品版圖

營收占比 35-40%



封測相關

導線架
鐳針
封裝零組件
切割刀具

35-40%



散熱相關

Heat Spreader
TIM
Die Attach Material

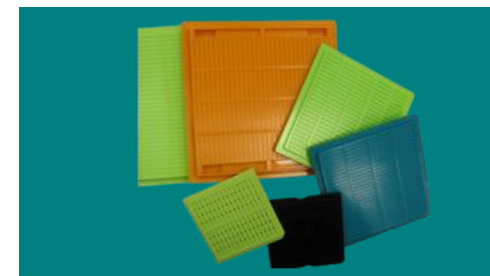
10-15%



載板相關

Memory IC
System IC

7-12%



LCD相關

Chip Tray
Emboss
Shipping Reel
OLED

3-5%

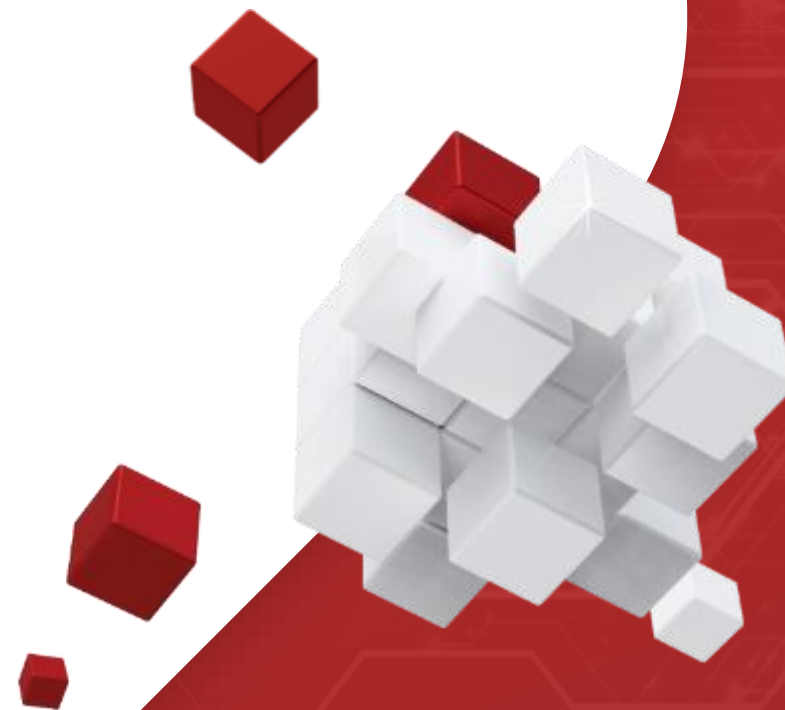
其他：銀漿、SSD外殼、真空閥門、機台設備與維修、醫材



02

2026 Q2 營運成果

動能延續 散熱高成長、載板回升





歷年營收/接單金額

- 2025 :

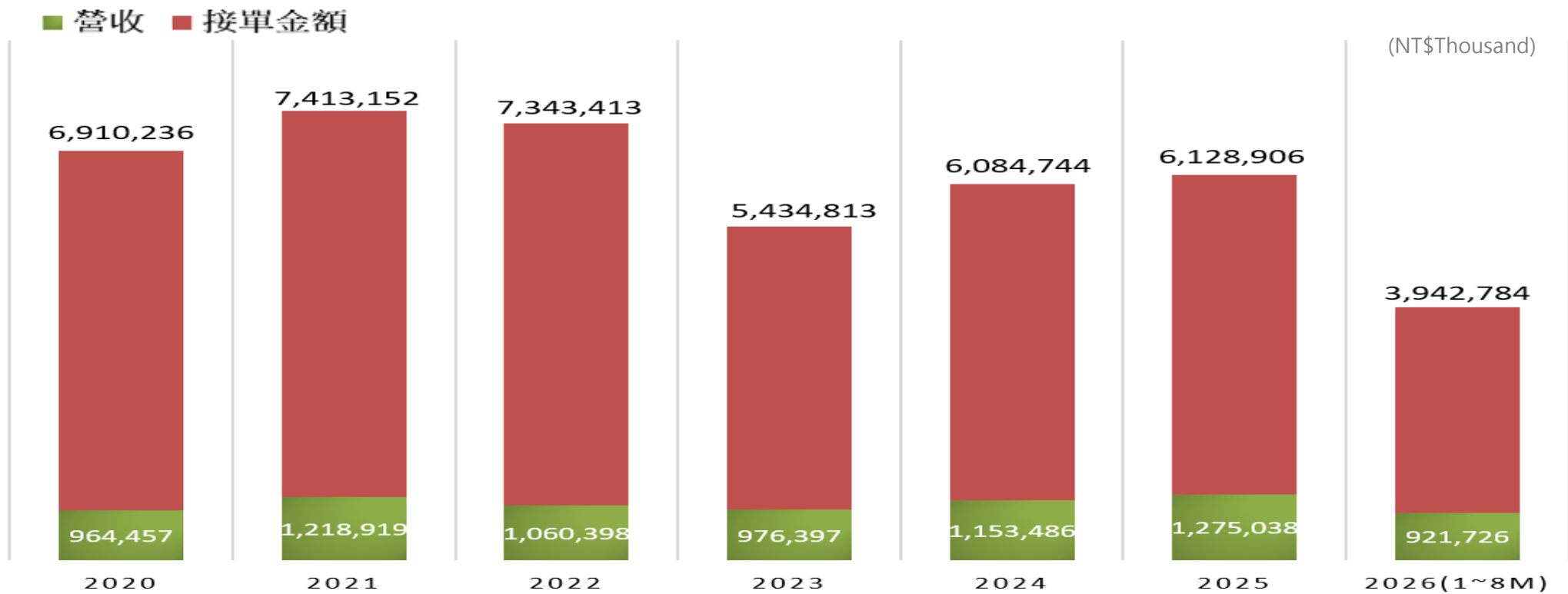
■ 營收 YoY=11% ,

■ 接單金額 YoY=0.7%
- 2013-2025 CAGR :

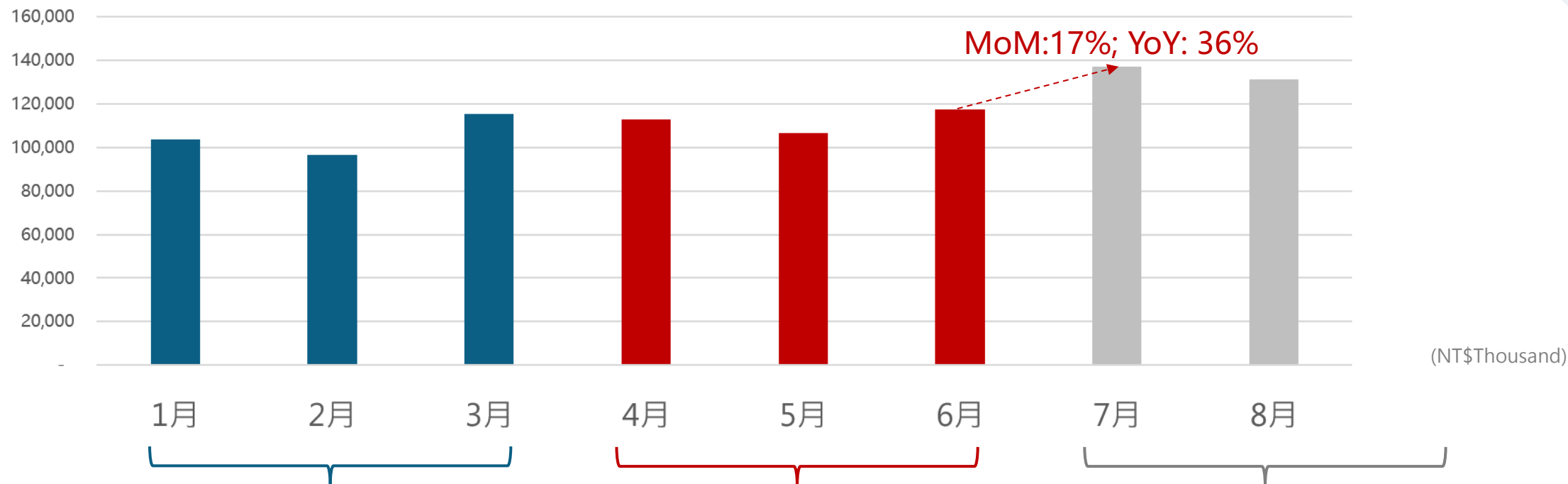
■ 營收 YoY=3.9%

■ 接單金額 YoY= 7.8%
- 營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)

■ 接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)



◆ 2026年各月營收



Q1 | 淡季不淡
 近14年同期新高
 散熱、封測、載板共同支撐

Q2 | 動能延續
 營收季增7%、年增5%
 散熱高成長、載板回升

Q3~ | 規模放大 獲利結構改善
 明鈞源併表
 載板與SSD外殼增添動能

綜合損益表

*尚未納入明鈞源營運成果

							2026年 Q2	
(NT\$仟元)	2022	2023	2024	2025	Q1 2026	Q2 2026	QoQ	YoY
營業收入	1,060,398	976,397	1,153,486	1,275,038	315,951	337,282	7%	5%
營業毛利	310,949	255,756	284,926	267,731	62,440	66,296	6%	-7%
毛利率	29%	26%	25%	21%	20%	20%	-1%	-11%
營業淨利	124,057	75,279	78,293	74,534	11,508	13,852	20%	-49%
營業外收(支)	110,067	36,565	65,185	36,005	12,247	18,472	51%	250%
稅前淨利	234,124	111,844	143,478	110,539	23,755	32,324	36%	116%
本期淨利	195,976	93,545	107,452	96,597	18,553	28,672	55%	54%
淨利率	18%	10%	9%	8%	6%	9%		
EPS (NT\$) 註:	4.90	2.12	2.39	2.15	0.41	0.64	56%	56%

註：係追溯調整後

資產負債表

*尚未納入明鈞源營運成果

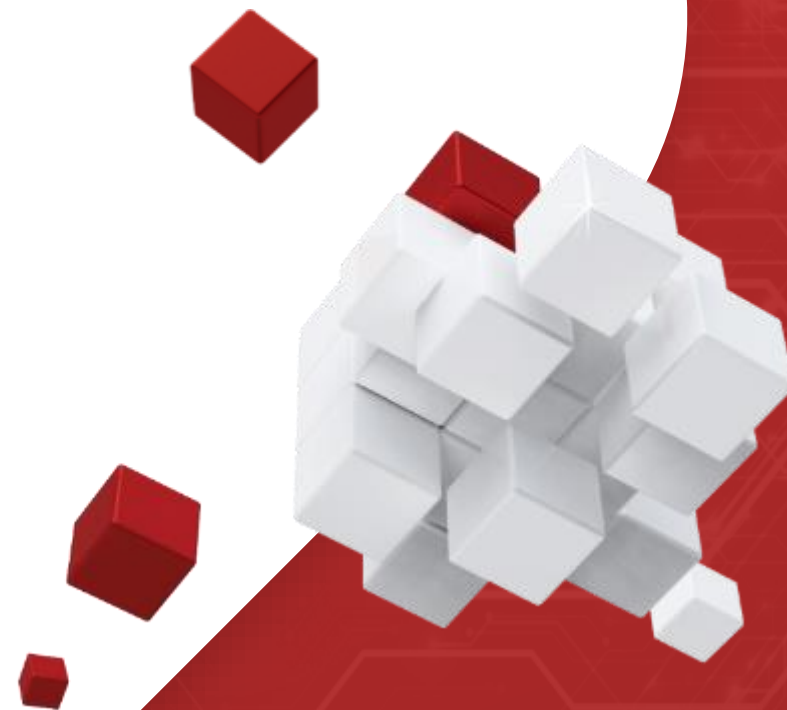
NT\$仟元	2022	2023	2024	2025	Q2 2026
資產					
現金及約當現金	327,431	398,797	333,159	509,696	707,777
應收帳款	532,247	443,432	550,367	455,480	414,424
存貨	60,048	67,008	60,611	65,653	47,368
轉投資相關	257,247	263,434	252,910	129,446	140,088
不動產、廠房及設備	226,154	223,341	286,419	289,547	297,451
其他資產	26,539	34,288	29,040	48,811	57,804
資產總計	1,429,666	1,430,300	1,512,506	1,498,633	1,664,912
負債					
短期借款	150,000	-	-	-	210,000
應付帳款	227,968	233,559	315,611	345,767	242,949
其他負債	131,435	110,272	122,610	73,780	162,581
負債總計	509,403	343,831	438,221	419,547	615,530
權益總計	920,263	1,086,469	1,074,285	1,079,086	1,049,382
淨值 (NT\$元 /股)	23.53	24.63	23.87	23.98	23.32



03

產品布局與發展

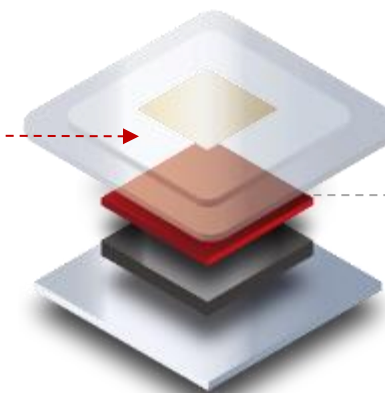
深化散熱與記憶體布局，擴大高價值產品組合



1 散熱解決方案

封裝導熱
total
solution
provider

1 Heat Spreader

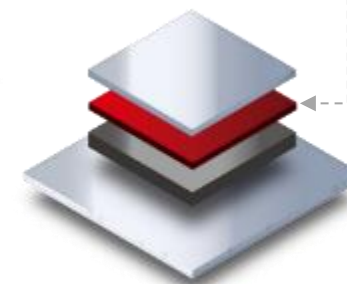


2 Ultra High Thermal Materials

Die Attach



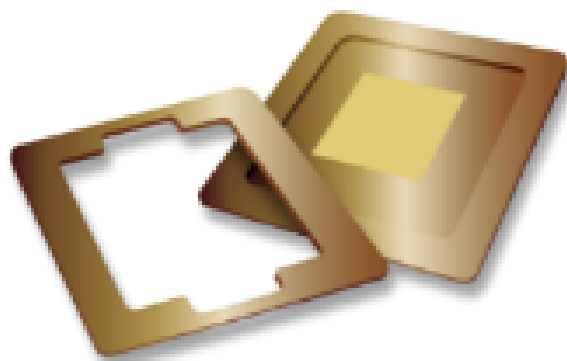
TIM1



1 散熱解決方案-均熱片(Heat Spreader)

跳躍式成長與市場實力

- 具備銅、鋁及不銹鋼材料的複合沖壓與精密 CNC 技術。
- 產銷合一，根據客戶散熱需求，快速調整材料配方與結構設計。
- 主要客戶包含日月光、力成、Amkor。



1 散熱解決方案-均熱片(Heat Spreader)

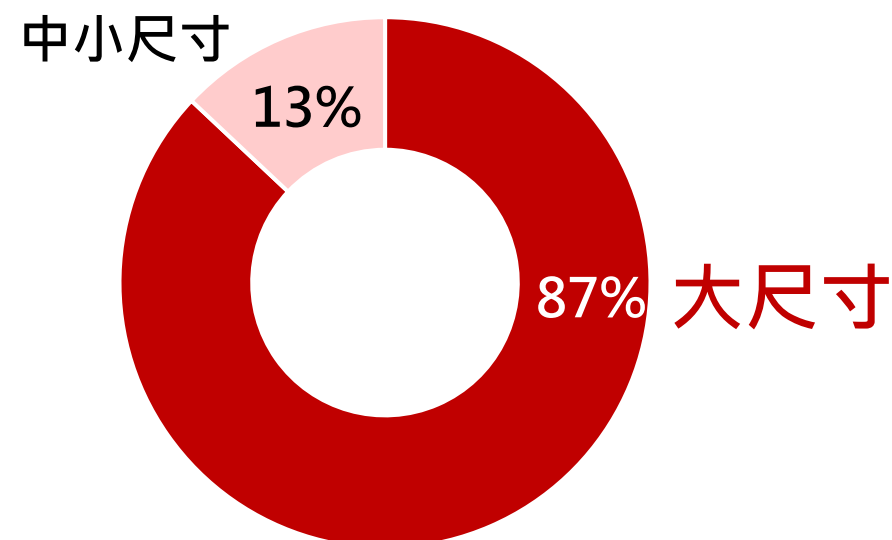
未來資本支出不會以單純擴大量能為主，

而是**配合客戶產品大型化與技術需求，增加高噸位沖壓及精密CNC能力**

- 台灣廠：大尺寸、高階產品
- 廣東廠：小尺寸、成熟產品
- 通過 IATF 16949 車規認證
- 台灣廠已增設500噸沖壓機



尺寸營收占比





散熱解決方案-導熱膠材 Thermal Adhesives



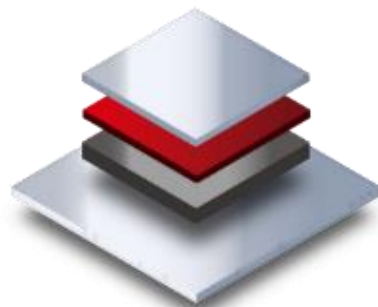
Ultra High Thermal Materials

←下一階段的獲利引擎

TIM1

HPC

- CPU
- GPU
- ASIC



持續驗證中

Die Attach

RF / PA Device

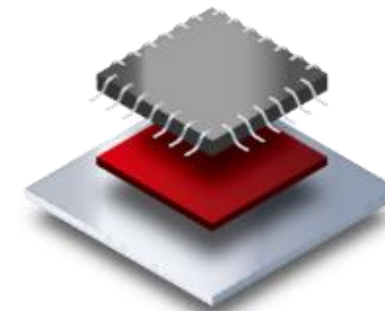
- Power Amplifier
 - GaAs
 - GaN

High Power LED

- Backlight
- Special Lighting
- Sensor

Power Device

- Module Assembly
- MOSFET/Driver
- GaN & SiC



小量出貨

2 SSD外殼

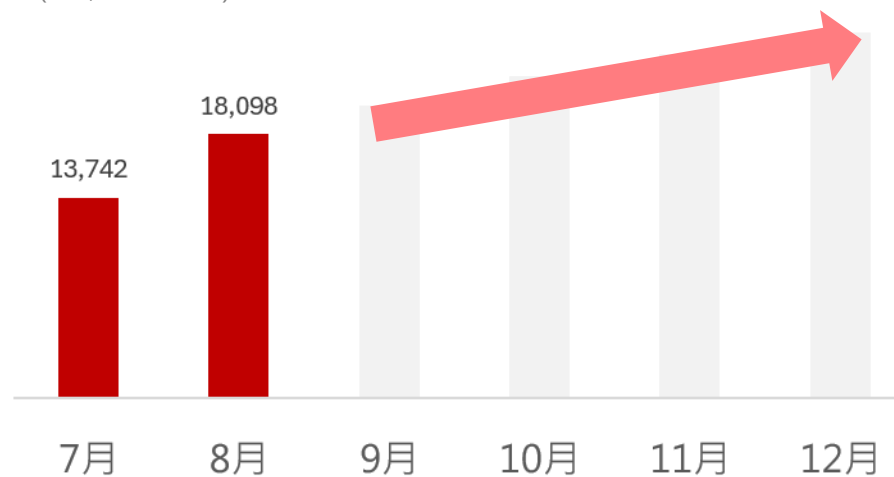
推升集團獲利結構轉型的關鍵成長引擎

市場機會

- 切入Kioxia / SSSTC體系
- 已通過客戶驗證
- 客戶積極擴張高階伺服器與企業級儲存市場
- 2026 ~ 2027進入放量期

營收 (合併後)

(NT\$Thousand)

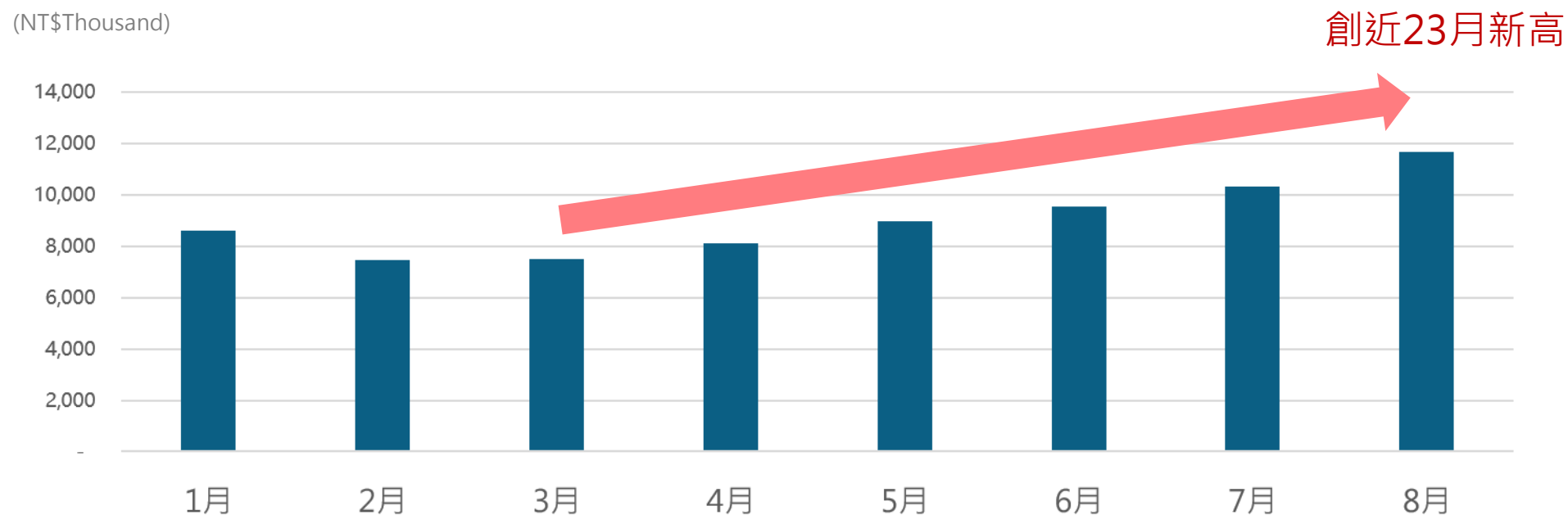


既有案量穩健成長、新案持續推進



3 載板 (Substrate)

記憶體需求回溫 + 漲價效應開始反映
 訂單能見度看至2027年下半年



4

持續拓展新代理與新產品

Promotion Phase

Under Qualification

Sales Ramp Up

1. Wafer inspection equipment

1st step – Equipment maintenance

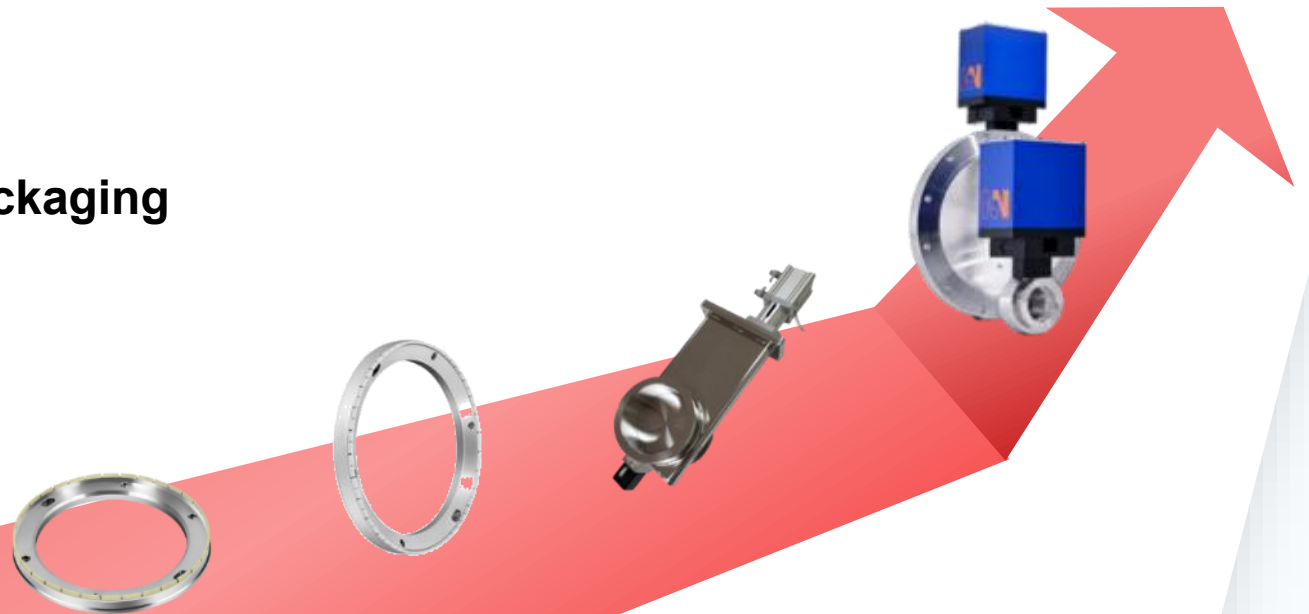
2nd step – Equipment selling

2. Wafer & IC testing – Probe card, BIB

3. Slurry of wafer grinding for advanced packaging

• 晶圓切割相關

• 真空閥門

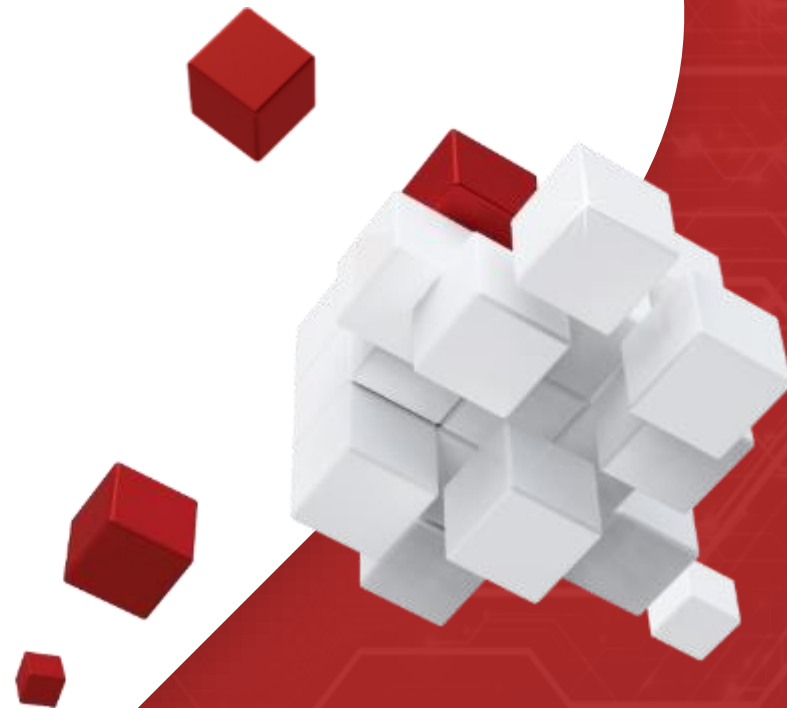




04

營運展望

高毛利產品放量 帶動獲利結構升級



1 2026 H2: 營收 + 獲利同步成長

產銷整合 × 高毛利產品放量 × 產品組合優化

下半年營收成長2~3成; 毛利率雙位數成長

01

明鈞源併表

營運規模放大

7月起完整認列營收與獲利



02

均熱片高階化

大尺寸 / CNC提升產品價值

高階產品比重提升



03

SSD外殼放量

新增獲利成長引擎

既有案成長 + 新案NPI推進



04

載板漲價反映

改善營收與獲利結構

供應改善、價格效益延續



*毛利率仍會受單月產品組合影響，整體改善趨勢不變

2 中長期營運展望



*毛利率仍會受單月產品組合影響，整體改善趨勢不變

Thanks

